# 数値計算によるによるホール推進機の寿命評価

## Influence on the thrust performance of Hall Thrusters by sputtering erosion

○伊藤 誠治(八戸工大・院)・石山 俊彦 (八戸工大)・根城 安則 (放送大)・田原弘一 (大阪工大)

Oseiji Ito( Hachinohe Institute of Technology Graduate School) • Toshihiko Ishiyama(Hachinohe Institute of Technology) • Yasunori Nejoh(The Open University of Japan) · Hirokazu Tahara(Osaka Institute of Technology)

#### Abstract (概要)

This paper describes the evaluation method of hall thruster's lifetime by numerical analysis. The existing formulas represents the sputtering characteristics for plasma particles sputter the wall. The author proposed that the existing formulas shall be added the effect of particles depositing on the wall. Based on the proposed formulas, the author compared the calculated results with the experimental data which were published from the several research institutions. The author aimed to make the accurate prediction of sputtering characteristics using the proposed formulas.

In the simulation, based on the physical sputtering formula reported by each research institute, the effect was added that the sputtered plasma particles are deposited on the inner wall surface of the hole thruster chamber or not.

The results of research will design a hall thruster that achieves both performance and durability.



記号の説明

- フィッティングパラメータ (ボダンスキーの公式) 0:
- f: フィッティングパラメータ (山村の式)
- Sn: 核阻止断面積
- Ψ: 表面結合エネルギー依存性
- Eth: しきい値エネルギー
- イオン衝突角度 cosα:
- 最大スパッタ時のイオン衝突角度 COSCont.



図1.1 ホール推進機の構造図

ホール推進機は高効率,長比推力といった特徴を持つため, 静止衛星や小惑星探査など宇宙開発の様々な局面で広く利用さ れており、 将来的には惑星間航行といった長期ミッションへの 投入も期待されている.

ホール推進機はイオン推進機と同じ静電加速型にカテゴライ ズされるが、イオン推進機と異なるところが多く、加速領域(放 電室)が準中性状態(プラズマ状態)である為、イオン推進機と比 較して推力密度が高いという特徴を持つ. その為, 様々なサイ ズのホール推進機を設計する事ができ、 ミッションへの柔軟性 が非常に高いと言える.

ホール推進機の推進剤は基本的に Xe(キセノン)や Ar(アルゴン) 等の希ガスが用いられる.

ホール推進機は図 1.1 に示すように円柱状の形状をしており, 加速チャンネルと呼ばれる放電室にてカソードから提供された 電子が磁力線に沿って移動しプロペラントタンクから提供され たキセノンガスと電離的に衝突する事でプラズマを生成し、プ ラズマをアノードとカソードの電位差で排気する事で推力を得 る仕組みになっている. カソードは電子を提供する機能を持つ ほかに、排気されたプラズマの空間電荷を中和する中和器とし ての機能を持っており、ホール推進機を搭載した宇宙機の帯電を 防ぐ役割を持つ.

しかし、ホール推進機は放電室の内壁がプラズマでスパッタ リングされると推進性能の低下や深刻な場合だと動作不良を引 き起こす等の問題がある.そして,スパッタリングされた粒子 が再度,内壁表面に付着し不純物として堆積することでスパッ タリング収率が増加するといった現象も発生する.

本研究では放電室内壁におけるスパッタリング収率の不純物 堆積による影響についてのシミュレーションを行った.

#### 2. スパッタリングシミュレーション

本研究で使用したスパッタリングモデル式は入射イオン一個 あたりの壁表面原子のスパッタリング収量を示す.

モデル式の導出にはイオン入射に対するスパッタリング収率 を決定するボダンスキーの公式を使用した. [7]

$$Y(E) = QS_n(\varepsilon)\Psi(x) \tag{1}$$

式(1)の*Q*はフィッティングパラメータであり,数値は図 2.1 の C. Garcia-Rosales のフィッティングデータより設定される.

$$Q = 1.633Z_1^{2/3}Z_2^{2/3}(Z_1^{2/3} + Z_2^{2/3})^{1/3} \frac{M_1^{5/6}M_2^{5/6}}{M_1 + M_2} \frac{0.15 + 0.05M_2/M_1}{1 + 0.05(M_2/M_1)^{1.6}}$$
(2)

式(2)内のZ<sub>1</sub>は入射イオンの原子番号,Z<sub>2</sub>はターゲット壁の原子 番号,M<sub>1</sub>は入射イオンの原子質量,M<sub>2</sub>はターゲット壁の原子質 量である.

式(1)内の Snは核阻止断面積であり、入射イオンとターゲット原子が衝突する割合を示す.

$$S_n(\varepsilon) = \frac{0.5ln(1+1.2288\varepsilon)}{\varepsilon + 0.1728 + \sqrt{\varepsilon} + 0.008\varepsilon^{0.1504}}$$
(3)

式(3)の ε はエネルギーパラメータとして表され[7],式(3)内の数 値は Lindhard が発表した核阻止断面積の近似値を用いた[7]. 式(1)内の Ψ は表面結合エネルギーの依存係数を示し、しきい値 領域のスパッタリングの挙動を意味する.

$$\Psi(x) = \left\{1 - \left(\frac{E_{th}}{E}\right)^{2/3}\right\} \left\{1 - \left(\frac{E_{th}}{E}\right)\right\}^2 \tag{4}$$

式(4)内の Ethはしきい値エネルギーを表し,

$$E_{th} = \left\{ 7.0 \left( \frac{M_2}{M_1} \right)^{-0.54} + 0.15 \left( \frac{M_2}{M_1} \right)^{1.12} \right\} E_s$$
(5)

式(5)のように表される.尚,式内の Esはターゲット壁の表面結 合エネルギーである.

ボダンスキーの公式のみではイオンの入射角度の説明ができ ない為、イオンの入射角度によるスパッタリング収率の依存性 を表す山村の式を導入した.[9]

$$Y(E, cos\alpha) = Y(E) * (cos\alpha)^{-f} exp(f[1 -$$

 $(cos\alpha)^{-1}])cos\alpha_{opt}$ 

式(6)内の Y(E)は入射イオンエネルギーによるスパッタリング 収量を示す為,ボダンスキーの公式を代入すると,

 $Y = QS_n \Psi(x)(\cos\alpha)^{-f} exp(f[-(\cos\alpha)^{-1}])\cos\alpha_{opt}$ (7)

式(3)に示すように本研究で使用するスパッタリングシミュレーションモデル式を導出できる.尚,式内のfは山村の式のフィッティングパラメータであり,入射するイオンとターゲット壁の原子の質量を表し以下のように表される.尚,式内の数値は図 2.2 の山村の入射エネルギーの入射イオンと壁材料原子の質量比との依存性のフィッティングデータから導入されている.

$$f = \sqrt{E_s} \left( 0.4 - 1.33 \times 10^{-3} \frac{M_2}{M_1} \right) \tag{8}$$

式(7)の cosa はイオン衝突角度を示し、cosaopt は最大スパッタ時の衝突角度を示し、以下のように表される.

$$\alpha_{opt} = \frac{\pi}{2} - \alpha_1 n^{-\frac{1}{3}} \left( 2 \frac{E_0}{E_{TF}} \sqrt{\frac{E_s}{\gamma E_0}} \right)^{-1/2}$$
(10)

シミュレーションモデルのフィッティングは入射イオンと壁 材料の原子番号(M1,M2)と原子質量(Z1,Z2),そして壁材料の表面結 合エネルギー(E<sub>6</sub>)の5種類のパラメータによって決定される. それぞれのパラメータの挙動はM1,M2,Z1,Z2の4種類については 入射イオンと壁材料によって決定され、イオン側の数値が高い場 合は重イオンが衝突する事になるので、スパッタリング収率は 増大する結果になり、逆にターゲット壁側の数値が高ければス パッタリング収率は減少する結果となる.表面結合エネルギー (E)は壁原子間の結合エネルギーを示し、イオン衝突時の壁原子 のスパッタのしづらさの指標であり、数値が高いとスパッタリ ング収率は減少し、数値が低ければスパッタリング収率は減少 する傾向にある.表面結合エネルギーの数値決定は報告されてい る材料損耗の報告データ[10,13]を元に数値調整を行って設定し た.

式(7)の基本モデルは不純物堆積を考慮しないシミュレーショ ンとして使用し、不純物堆積を考慮する場合のシミュレーショ ンはモデル式のパラメータ内の表面結合エネルギーの数値を下 げて設定を行った.表面結合エネルギーの数値を下げる理由と しては、壁表面は不純物が付着すると表面結合エネルギーが低下 するという現象が発生するためである.表面結合エネルギーが低下 するという現象が発生するためである.表面結合エネルギーが低下 するという現象が発生するためである.表面結合エネルギーが低下 するという現象が発生するためである.表面結合エネルギーが低下 するという現象が発生するためである.表面結合エネルギーが低 下する詳しいメカニズムについては考察にて記す. 以下の図1に、表面結合エネルギーの変更によるスパッタリン グ収率の変化の例を示す.図2.3より、表面結合エネルギーが増 大すると壁原子をスパッタリングさせるためには必要なイオン の入射エネルギーが多く必要な為、結果としてスパッタリング収 率が低下する.次に表面結合エネルギーが低下すると、壁原子を スパッタリングする為の入射エネルギーは少なく済むため,結果 としてスパッタリング収率は増大する.



図 2.1 C. Garcia-Rosale フィッティングデータ(文献[8]より転載)



図2.2 入射エネルギーの入射イオン・壁材料原子質量比との依存性のフィッティングデータ(文献9より転載)



図2.3 スパッタリング収率の表面結合エネルギーEs との依存性

#### 3. シミュレーション結果

導出したモデル式を元に放電室内壁におけるスパッタリング をシミュレーションした.今回のシミュレーションでは放電室 内壁の大部分に使用される窒化ホウ素(BN)とアノードに使用さ れる銅(Cu)を想定して行い,報告されている実験データとの比較 を行った.

BN 材料のシミュレーションは、今回は二種類の HBR-BN と HBC-BN の報告データとの比較を行った. HBR-BN は焼結・形成 時に固着剤としてホウ酸カルシウムを使用した BN 材料であり、 一方で HBC-BN は製造過程において固着剤を使用しない高純度 の BN 材料である.

図 3.1 と図 3.2 に BN 材料のシミュレーション結果を示す.シ ミュレーション結果からイオン衝突エネルギー(projection energy) が増加するとスパッタリング収率は増大するが、低エネルギー 領域ではスパッタリング収率は急激に低下する傾向にある.

報告されている実験データとの比較では、固着剤を使用しない HBR-BN の場合は固着剤によって不純物堆積が発生しやすい為、 スパッタリング収率は増大する傾向にあり、不純物堆積を考慮 した場合のシミュレーションとよく一致する結果となり、実験 結果に示される傾向をよく説明できた.次に固着剤を使用しな い HBC-BN の場合は不純物堆積が発生しにくい為、スパッタリ ング収率は低下する傾向にあり、不純物堆積を考慮しない場合の シミュレーションとよく一致する結果となり、実験結果に示さ れる傾向をよく説明できた.

次にアノードに使用されている銅(Cu)のシミュレーション結果 を図 3.3 に示す.シミュレーション結果から、イオン衝突エネル ギーが増加するとスパッタリング収率も増加するという BN 材料 と同じ傾向が見られた.しかし、低エネルギー領域ではスパッ タリング収率は BN 材料よりも急激に低下し、更には不純物堆積 を考慮した場合としない場合で差はあまり出ない結果となった. このような結果となった原因としては、Cu は BN と比較して重 い元素である為、不純物堆積による影響は受けにくい為と考え られる.

ホール推進機の放電室の内壁を構成する材料について、シミ ュレーション結果と報告された実験結果[10,13]を比較すると、不 純物堆積を考慮した場合の方が実験結果をよく説明することが できた.不純物が堆積することで、スパッタリング収率が影響 を受けることについては、考察にて議論する.





図 3.2 HBC-BN のスパッタリング率のシミュレーション結果 [10]



図3.3 Cuのスパッタリング率のシミュレーション結果[13]

4. 考察

不純物堆積によるスパッタリング収率の増大メカニズムのマ クロ的に示すと図4.1の様に表される.内壁表面からスパッタリ ングして飛散した原子の一部が,再度内壁に入射することで,内 壁表面をスパッタリングもしくは不純物として堆積するといっ た現象が発生する. [14]

これにより、スパッタ原子の挙動を考慮することで、不純物堆 積の増加を説明することができ、スパッタ原子の再度スパッタ リングによってスパッタリング収率の増加についても説明でき る.

次に、不純物堆積による壁材料のスパッタリング収率の増加に ついてミクロ的に示すと図4.2の様に表される.内壁表面は衝突 連鎖によって壁材料と不純物は混成され、内壁を構成する材料 の組成が変化する.[15] そして、更にその過程で、内壁の表面 エネルギーが低下していく為、結果としてスパッタリング収率 は増大していくものと考えられる.[16]

このような材料の混成は高温環境下にて発生しやすく,温度 上昇によってスパッタ原子は材料内で拡散しやすくなり,材料 の組成変化が発生しやすくなる.

ホール推進機は長時間稼働させると、結果的に放電室内は高

温になりやすく、結果として先述した内壁材料の組成変化が発 生し、耐久性が低下することでスパッタリング収率が増加する. スパッタリング収率が増加すると推進性能が低下するだけでは なく、深刻なケースだと動作不良が発生する可能性が大きくな る.



図4.1 スパッタリングされた原子の壁への堆積と再スパッタ (マクロ的描像)

[文献 14 をもとに作成]



図 4.2 不純物堆積によるスパッタリング収率増大のメカニズム (ミクロ的描像)

#### 5. まとめ

本研究では、ホール推進機の性能向上を目的に、各研究機関 で検討されてきた放電室の内壁への理論的なスパッタリング現 象の評価に、放出されたプラズマ粒子の内壁表面への不純物堆 積効果を付加した形で、定式化を検討した. 作成したシミュレ ーションモデル式をもとに、各研究機関から発表された実測デ ータと比較すること、スパッタリング特性の高精度な予測を可 能にすることを目指した.

シミュレーション結果と報告されている測定値を比較した結果, 以下のことが示された.

- ・イオン衝突エネルギーが増加することで、スパッタリング率 も増加した.
- ・不純物堆積を考慮した場合と不純物堆積を考慮しない場合を 比較すると、不純物堆積を考慮した場合の方がスパッタリン グ率は増大することが示された。
- ・各種の材料によって、スパッタリング率は変化することが示 された.

不純物堆積を考慮した場合、スパッタリング収率が増大する現象については、不純物が内壁表面に堆積することで表面エネル

ギーが低下し、スパッタリングが促進されることが指摘されて いる.スパッタされたプラズマ粒子がホール推進機の放電室内 壁表面に不純物として堆積することで、壁材料(を構成する物質

(窒化ホウ素、銅など)の表面結合エネルギーが低下し,壁表 面の組成が変化することで本来の耐久性が失われる.この効果 によって,壁面への堆積がない場合に比べて,スパッタリング 率は増大する.本研究でのシミュレーションをもとに検討した ところ,この現象が再現できた.

本研究で得られた知見を活かすことで、高性能と耐久性を両立 させたホールスラスタが設計、製造できるであろうこと、そし て将来には、この過程で製造されたホールスラスタを搭載した 深宇宙探査機が活動することが期待される.

### 6. 参考文献

 栗木恭一, 荒川義博. 電気推進ロケット入門, 東京大学出版 会, pp. 7-11, (2003).

2. ホールスラスタ研究会 - 九州大学 中島研究室.

<http://art.aees.kyushu-u.ac.jp/research/Hall/inspace/principle.html>

3. 國中均, 西山 和孝, 中山 宜典, イオンエンジンによる動力 航行 (宇宙工学シリーズ). コロナ社, p. 19, (2006).

4. 栗木恭一, 荒川義博. 電気推進ロケット入門, 東京大学出版 会, p. 21, (2003).

5. 渡邊裕樹, イオンエンジン加速電極の損耗予測技術, 第19回 若手科学者によるプラズマ研究会, (2016).

6. Francesco Taccogna, Savino Longo, "Geometrical Scaling of Hall Thruster Particle Model" pp. 1119-1124, (2009)

7. J. Bohdansky, "A Universal relation for the sputtering yield of monatomic dolids at normal ion incidebce" Nuclear Instruments and Methods in Physis Research B2 pp. 587-591 (1984).

8. C. Garcia-Rosales, W. Eckstein, J. Roth, "Revised formulate for spuutering data", Journal of Nuclear Materials 218 pp. 8-17 (1994)

9. Yasumichi Yamamura, Yukikazu Itikawa, Noriaki Itoh, "Anugular depemdemce of sputtering yields of monatomic solids" IPPJ-AM-26 pp. 1-16 (1983).

10. B. Rubin, J. L. Topper, and A. P. Yalin, "Total and Differential Sputter Yields of Boron Nitride Measured by Quartz Crystal Microbalance", IEPC-2009-042, pp. 1-18, (2009).

11.BN セラミックス(モメンティブ・パフォーマンス・マテリアル ズ・ジャパン合同会社)

<https://www.ipros.jp/product/detail/2000289830/>

12. 國中均,西山和孝,中山宜典,イオンエンジンによる動力 航行 (宇宙工学シリーズ). コロナ社, p. 70, (2006)

13. E. S. Wise, MS Liu, and T Miller, "Sputtering of cubic metal crystals by low-energy xenon-ions", Computational Materials Science, Vol. 107, pp. 102-109, (2015).

14. M. Warrier, et al, "Subroutines for some plasma surface interaction processes: physical sputtering, chemical erosion, radiation enhanced sublimation, backscattering and thermal evaporation", Computer Physics Communications, Vol. 160, pp. 46-68, (2004).

15. 大宅薫、損耗・再堆積の計算機シミュレーション、プラズマ・ 核融合学会誌、Vol. 77, No. 9, pp. 874-878 (2001).

 吉原 一紘,新居 和嘉, "ホウ素と窒素を添加した 18-8 ス テンレス鋼表面上への窒化ホウ素の析出挙動",日本金属学会
誌, Vol. 47, No. 11, pp. 941-949, (1983).

17. N.Sasaki, Y.N.Nejoh and H.Tahara, Proc. 29th Intern'I Spase Tech. Symp, P,P.131. (2013).

18. H.Tahara, JIEE Jpn, Vol.129, (2009).